

关于成都蕊源半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的

上市保荐书

保荐人



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

关于成都蕊源半导体科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的上市保荐书

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

成都蕊源半导体科技股份有限公司（以下简称“蕊源”、“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“本机构”、“保荐机构”或“中金公司”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《成都蕊源半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》中相同的含义。

一、本次证券发行的基本情况

（一）发行人基本情况

中文名称	成都蕊源半导体科技股份有限公司
英文名称	RYCHIP Semiconductor Inc.
注册资本	4,257.8012 万元
法定代表人	杨楷
成立日期	2016 年 7 月 19 日
整体变更为股份有限公司日期	2021 年 4 月 25 日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 1 号楼 A 区 3 层 301、302、303、304-1 室
实际控制人	袁小云、刘涛、杨楷
邮政编码	610095
电话	028-85153970
互联网地址	www.rychip.com
电子邮箱	rychip@rychip.com
经营范围	半导体技术开发；电子元器件、集成电路设计；销售计算机软硬件及技术咨询、技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
行业分类	软件和信息技术服务业（分类代码：I65）
在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
部门负责人	杨浩波

（二）发行人的主营业务

公司专业从事电源管理芯片的研发、设计、封测和销售，是细分领域知名的自主品牌电源管理芯片企业。公司产品以 DC-DC 芯片为主，同时涵盖保护芯片、充电管理芯片、LDO 芯片、LED 驱动芯片、马达驱动芯片、PMU 芯片、复位芯片等多系列电源管理芯片，其中公司 DC-DC 芯片已进入众多优质终端客户供应链体系，在细分领域市场占据较高市场份额，具备突出的市场竞争力。

截至报告期末，公司可售芯片型号近 1,600 款，其中 DC-DC 芯片共 460 余款，支持多种电压电流转换、多种开关频率、多种功能模式、多种封装形式，可广泛应用于网络通信、安防监控、智能电力、消费电子、智慧照明、工业控制、医疗仪器、汽车电子

等众多领域。**2022** 年公司芯片总销量达 **13.94** 亿颗，其中 DC-DC 芯片总销量达 **11.69** 亿颗。

目前，公司产品已进入众多优质终端客户供应链体系，在网络通信、安防监控、智能电力、消费电子、智慧照明、工业控制等细分领域形成了丰富的知名客户资源。其中网络通信领域在合作客户包括中兴通讯、创维数字、普联技术、九联科技、星网锐捷、富士康等，安防监控领域在合作客户包括海康威视、萤石科技等，智能电力领域在合作客户包括智芯微、中睿昊天、鼎信通信、威胜信息、**力合微**等，消费电子领域在合作客户包括安克创新、云鲸、Shark Ninja 等，智慧照明领域在合作客户包括凯耀照明、中电海康等，工业控制领域在合作客户包括迪文科技、大豪科技等。

基于众多优质客户合作基础，公司 DC-DC 芯片在网络通信、安防监控、智能电力等终端场景的部分细分领域已占据较高市场份额。经测算，2021 年，公司 DC-DC 芯片在网络通信场景的机顶盒、无线路由器及 ONT 细分领域市场份额达 13%，在安防监控场景的摄像头及 NVR/DVR 细分领域市场份额达 8%，在智能电力场景的 HPLC 模块细分领域市场份额达 10%，并在 **2022 年度**提升至约 **50%**。

同时，目前公司已形成了“设计+封测”的协同产业布局，基于自有封测产能，公司得以进一步加强在成本控制、质量控制、交付周期等多方面的市场竞争力，从而巩固并提高公司的市场地位。

（三）发行人的核心技术与研发水平

1、发行人主要核心技术

公司专注于电源管理芯片，目前可售型号近 **1,600** 款，**2022** 年公司芯片总销量达 **13.94** 亿颗，广泛应用于多个终端产品。在多年开发过程中，公司在电源管理芯片设计方面积累形成了多项核心技术，为公司新产品开发量产提供了有力技术支撑。

公司核心技术均来源于自主研发，其具体内容、专利保护情况及在产品中应用情况如下：

序号	核心技术	技术来源	专利保护	主要应用产品
1	非对称低阻抗 MOS 管技术	自主研发	-	多类型电源管理芯片
2	五管运放单元模块技术	自主研发	-	多类型电源管理芯片

序号	核心技术	技术来源	专利保护	主要应用产品
3	广输入高稳定电压控制技术	自主研发	发明专利 (202110273281.8)	多类型电源管理芯片
4	电流模 Buck 直流转换器高速响应技术	自主研发	发明专利 (202110284067.2)	DC-DC 芯片
5	DC-DC 芯片低电磁干扰技术	自主研发	发明专利 (202110445650.7)	DC-DC 芯片
6	带温度补偿的全范围输入电压调节器技术	自主研发	发明专利 (202110365124X)	DC-DC 芯片
7	限流双保护技术	自主研发	发明专利 (202110147494.6)	马达驱动芯片等
8	高兼容性 SOT 封装引线框架	自主研发	实用新型专利 (201920602529.9)	芯片封装

(1) 非对称低阻抗 MOS 管技术

MOS 管是集成电路中主要器件之一，芯片设计企业通常采用晶圆厂提供的包含 MOS 管在内的标准器件库进行芯片设计。公司基于对半导体器件工艺的深刻认识，充分发掘工艺潜能，通过精细调整包括注入浓度、褪火、扩散梯度等晶圆工艺参数，在不增加甚至减少光罩的前提下，实现同等硅片面积及耐压水平下导通电阻更低，在此基础上针对 MOS 管器件采用非对称结构设计，使得器件尺寸大幅降低，其中 5V MOS 管实际沟道长度明显低于标准器件库中 MOS 管沟道长度，实现同等性能下器件面积减小约 20%。

(2) 五管运放单元模块技术

运放单元是电源管理芯片中广泛应用的模块，是 DC-DC 芯片输出电压精度控制的基础，也是各类信号采样放大的必需模块，行业通常采用 Cascode 结构的运放单元以达到高增益高精度等性能指标，公司深入挖掘五管运放单元的性能潜力，适配芯片整体设计和模块功能需求合理分配指标，实现了最简结构的运放单元在 DC-DC 芯片中的广泛应用，同等性能下运放模块面积仅为 Cascode 结构的三分之一。

(3) 广输入高稳定电压控制技术

由于电源管理芯片内处理高电压的器件面积占用较大，为节约芯片面积，高电压输入芯片后需转换成低电压，因此高低电压转换模块是电源管理芯片内必不可少且非常重要的模块。公司具有多年高低电压转换模块设计经验，形成了广输入高稳定电压控制技术。广输入方面，公司高低电压转换模块能够在较宽的输入电压范围内正常工作，显著

拓展公司电源管理芯片的应用范围，例如在以电池为电源的移动式设备中，广输入特性能够大幅延长设备的电池使用时间；高稳定方面，公司高低电压转换模块能够为电源管理芯片内提供极稳定的 5V 电压，保证芯片内部各功能模块处于最佳工作区间，大幅减少芯片内部工作电压受输入电压、输出电压、负载电流及芯片温度等因素变化的影响，在负载发生跳变时亦能保持稳定，是公司电源管理芯片实现高性能、低噪声、快速响应的基础。

（4）电流模 Buck 型 DC-DC 芯片高速响应技术

传统电流模 Buck 型 DC-DC 芯片在负载发生快速变化时会发生输出跌落，而芯片直至下一个时钟开始才能检测跌落并做出响应，这种反馈机制原理导致基于该等电路架构的 DC-DC 芯片在负载跳变时输出电压的变化幅度较大。公司基于多年电路设计经验和对电路架构的深刻理解，开发出电流模 Buck 型 DC-DC 芯片高速响应技术，在传统电路架构的基础上加快电路对负载跳变的响应过程，使得输出电压波动范围更窄。公司的电流模 Buck 型 DC-DC 芯片高速响应技术在保持电流模芯片稳定、易于补偿等特性的同时，提高了芯片的响应能力，拓宽了公司电源管理芯片的应用领域，满足终端应用对输入电压的严苛要求。

（5）DC-DC 芯片低电磁干扰技术

DC-DC 芯片工作过程中存在高频率开关切换及大电流持续充放电，会对电源线产生电磁干扰，且若 DC-DC 芯片的开关频率与终端应用所关注的特定频率一致则影响更大。公司基于对芯片工作条件的深刻理解，开发了 DC-DC 芯片低电磁干扰技术，显著减小了 DC-DC 芯片对系统电源的电磁干扰，降低终端客户产品设计开发的集成难度。

（6）带温度补偿的全范围输入电压调节器技术

为减小芯片面积，高输入电压的 DC-DC 芯片一般会将输入的高电压调整为 5V 以供内部各功能模块工作。由于输入电压一般会有较大波动，需由电压调节器进行调整，而环境温度变化及芯片重载输出时的发热则使得电压调节器面临恶劣工作环境。为此，公司开发了一种带温度补偿的全范围输入电压调节器，能够用在多种输入电压下，自主补偿芯片所处的环境温度变化。

（7）限流双保护技术

在马达驱动等部分需要大功率输出的应用中，为避免过热和烧毁等情形发生，需对

输出电流加以限制。公司自主开发的限流双保护技术能够为过流故障建立多重防护屏障，使系统处于安全工作区域，保护驱动芯片本身及马达不受电路过流损害，并在故障因素撤销后保证系统各功能模块正常工作。

（8）高兼容性 SOT 封装引线框架

由于不同终端应用的 SMT 工艺有所不同，因此相同芯片面向不同终端销售时需采用适配相应 SMT 工艺的不同封装形式。公司开发了一种高兼容性的 SOT 封装引线框架，已应用在自有封装生产线，该封装引线框架使得芯片采用相同封装形式便可适配多种 SMT 工艺，大幅提高了公司供应链管理效率及封测生产效率。

2、发行人研发水平

（1）核心技术人员

截至报告期末，公司研发人员 37 人。公司核心技术人员包括袁小云等 3 人，2022 年 6 月，公司原核心技术人员吴国栋离职，除此之外，报告期内公司不存在核心技术人员变动情况。核心技术人员的基本情况如下：

1) 袁小云

袁小云，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月毕业于西安交通大学微电子专业，获得硕士学位。2004 年 4 月至 2006 年 12 月，于技领半导体（上海）有限公司从事设计工作；2007 年 1 月至 2011 年 1 月，于捷顶微电子（上海）有限公司从事设计工作；2011 年 2 月至 2013 年 11 月，于西安航天民芯科技有限公司从事设计工作；2013 年 12 月至 2016 年 6 月，于武汉育溪科技有限公司从事设计工作；2016 年 7 月设立蕊源有限，2016 年 7 月至 2019 年 5 月，担任蕊源有限首席技术官，2019 年 5 月至 2020 年 2 月，担任蕊源有限董事，2020 年 2 月至今，担任蕊源有限/发行人董事长；2021 年 3 月至今担任四川蕊源总经理；2021 年 6 月起担任上海安诺执行董事；2021 年 7 月至今担任浙江安诺执行董事兼总经理。

袁小云拥有近 20 年电源管理芯片设计经验，对半导体器件及电路设计具有深刻理解，主导参与公司大多数技术及产品的研发工作，是公司多项核心技术的主要开发者。

2) 张勇文

张勇文，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月毕业

于电子科技大学光学专业。2013年6月至2018年5月任职于芯源系统有限公司，担任测试工程师；2018年5月加入公司，目前担任测试工程师主管。张勇文具有多年芯片测试经验，是公司芯片大电流专用测试组件的主要开发人员。

3) 邱欣

邱欣，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月毕业于西南科技大学应用物理学专业，获得学士学位。2013年1月至2017年3月，于成都芯源系统有限公司担任模拟版图设计工程师；2017年5月至2018年6月，于杰夫微电子（四川）有限公司担任版图设计主管；2018年6月加入发行人，担任版图设计主管；2021年2月至今，担任蕊源有限/发行人监事。邱欣拥有近10年版图设计经验，为公司产品实现优异性能做出重要技术贡献。

为了充分调动核心技术人员的工作积极性，保持团队稳定性，公司建立了针对核心技术人员的管理体系和激励制度。管理措施方面，公司通过签署保密协议、竞业禁止条款、股权禁售期安排等多种方式进行约束；激励措施方面，公司采用有市场竞争力的薪酬、员工持股、项目奖金、绩效激励等措施，帮助核心技术人员实现自我价值和企业发展方向的统一。

(2) 发行人的科研项目

截至报告期末，公司主要在研项目情况如下：

序号	项目概要	经费投入 (万元)	项目 进度	研发目标	与行业技术水平的比较	相应人员
1	5.5V 1uA 低功耗线性稳压器芯片项目 (M049)	144.97	进行中	在低于 1uA 的静态电流情况下，有出色的抗噪声能力和高达 80dB 的 PSRR	1uA 的静态电流下，PSRR 高于 RT9078 的 75dB，达到国内同等水平	项目研发总监、评审组及工程师团队共 4 人
2	低压三相马达驱动电路 (M079)	103.59	进行中	实现可外接限流电阻与外置比较器、MCU 等限流控制，带有欠压锁定、过流保护、过热保护等保护功能，采用三路 1/2-H 桥输出，具有较低工作电压范围（6V~12V），大电流（2.0A）输出等特点	输出电流能力超过 MP6543 产品性能，内阻，耐压等与 MP6543 保持一致，达到国际同等水平	项目研发总监、评审组及工程师团队共 4 人
3	高压步进马达驱动电路项目 (M062)	158.03	进行中	具有限流功能、能实现细分步进控制的马达驱动电路，带有 UVLO、OCP、TSD 等保护功能，采用 H 桥输出，具有宽电压输入范围（8.2V~36V），大	性能参数耐压、输出电流能力超过 AT8812,AT8812C，达到国内	项目研发总监、评审组及工程师团队共 4 人

序号	项目概要	经费投入 (万元)	项目 进度	研发目标	与行业技术水 平的比较	相应人员
				电流（3.6A）输出等特点。	领先性能	
4	高压直流马达 驱动电路项目 (M052)	161.26	进行中	实现具有限流功能，带有欠压 锁定、过流保护、过热保护等 保护功能，采用 H 桥输出，具 有宽电压输入范围 (6.5V~36V) 和大电流 (3.6A) 输出等特点的大功率直流马达 驱动电路	性能参数输出 电流能力，输 入电压，内阻 与 DRV8870 一致，达到国 际同等水平	项目研发总 监、评审组 及工程师团 队共 4 人

（四）主要经营和财务数据及指标

报告期内，发行人财务报表主要财务数据及财务指标如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.59	6.21	2.37
速动比率（倍）	1.50	4.80	1.41
资产负债率（母公司）	16.29%	5.18%	13.32%
资产负债率（合并）	25.33%	14.47%	30.07%
归属于发行人股东的每股 净资产（元/股）	7.72	6.79	2.42

注：上述各指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
- 4、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末股本（实收资本）总额

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次/年）	3.84	6.90	4.62
存货周转率（次/年）	2.11	3.91	2.76
息税折旧摊销前利润（万元）	9,144.78	12,050.84	1,063.79
利息保障倍数（倍）	244.73	102.57	28.20
研发投入占营业收入的比例	5.92%	4.87%	10.71%
每股经营活动的现金流量（元/股）	0.00	1.12	-0.30
每股净现金流量（元/股）	-1.28	1.91	0.02
归属于发行人股东的净利润（万元）	6,812.48	9,374.43	824.28
归属于发行人股东扣除非经常性损 益后的净利润（万元）	6,721.05	9,119.66	803.53

注：上述各指标计算公式如下：

- 1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 2、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 3、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 4、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
- 5、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- 6、每股经营活动的现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本（实收资本）
- 7、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末总股本（实收资本）
- 8、归属于发行人股东的净利润=净利润-少数股东损益
- 9、归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=净利润-少数股东损益-税后非经常性损益

（五）发行人存在的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）营业收入、经营业绩、产品价格及毛利率等下降的风险

1) 收入及经营业绩下降的风险

2022 年初以来，市场前期“缺芯”问题已逐步得到缓解，行业存货水平逐步回升，景气度较 2021 年中的高位有所回落，终端及渠道由“缺芯”阶段的备货导向逐步转变为去库存导向，产品价格存在一定下行压力。2022 年度，受终端需求周期性波动、晶圆流转周期较长、新品量产推迟、夏季四川高温限电、经济下行等多方面因素影响，公司营业收入同比减少 8.78%，净利润同比减少 27.33%，扣除非经常性损益后的净利润同比减少 26.30%。如未来前述对半导体行业或公司的一项或多项负面影响因素持续对公司经营造成不利影响，或发生国际/地区政治局势变化、终端市场下滑等负面事件，公司将面临营业收入下滑并进而导致公司经营业绩下滑的风险。

2) 产品价格下降的风险

报告期内，受市场供需关系等影响，公司的产品销售均价分别为 103.30 元/千颗、173.65 元/千颗及 213.12 元/千颗，其中 2021 年度及 2022 年度产品销售平均单价上涨较快。如未来受市场供需关系变动、公司产品竞争力减弱等因素影响，公司产品销售单价可能下降，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

3) 毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 33.46%、46.26%及 **40.51%**，总体呈波动上升趋势，其中 2021 年度毛利率增幅较大。公司综合毛利率受产品售价、产品线结构等因素综合影响，而产品售价很大程度上取决于公司产品的竞争力，以及行业与主要下游行业的景气程度。为了确保市场竞争力，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新。若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本，或竞争对手大幅扩产、采取降价措施等导致公司产品售价下降、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等，将给公司的经营带来一定风险，进而导致公司综合毛利率水平下降。

2022 年度，公司的综合毛利率为 **40.51%**，较 2021 年度综合毛利率 46.26%下降 **5.75** 个百分点，主要原因系 2022 年下半年受晶圆流转周期较长、四川等地高温限电及**经济下行**等多方面因素影响。如未来上述不利因素未能消除或进一步恶化，则公司未来毛利率面临进一步下降的风险。

(2) 采购及供应商相关风险

1) 晶圆委外加工模式及晶圆供应商集中的风险

目前，公司采用“设计+封测”的经营模式，将晶圆制造环节委托代工厂完成。虽然晶圆制造委外有利于提高公司经营效率，但该经营模式下晶圆制造的工艺水平、生产能力、产品质量、交付周期等因素对公司产品的销售存在重要影响。此外，由于晶圆制造为资本及技术密集型产业，行业集中度较高，主流供应商具有较大的经营规模及较强的市场影响力，可能形成较高的依赖性。供应商 A 自 2020 年度起成为公司第一大供应商，且公司于 **2021-2022 年度**向供应商 A 采购金额占比超过 50%，占比相对较高，公司与供应商 A 之间未以书面合同形式就产能保障予以约定。目前在半导体产业供需关系波动的影响下，上游晶圆制造产能相对紧缺，若上游供应商出现产能不足的情形，将对公司产品交付稳定性造成直接影响。同时若上游晶圆代工厂出现突发经营异常或与公司的合作关系出现不利变化，公司亦可能面临无法投产、无法交货等风险。

2) 原材料价格波动风险

公司采购的产品和服务主要包括晶圆、封装测试服务、中测服务、封测原材料等。2020 年度、2021 年度及 **2022 年度**，公司晶圆采购金额占公司当期采购总额的比例分别

为 60.21%、56.63%及 **71.96%**。公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，如果主要原材料采购价格出现大幅波动，将直接导致公司产品成本出现波动，进而影响公司的盈利能力。

(3) 销售及客户相关风险

1) 2022 年度第一大客户系关联方且收入占比增幅较大的风险

公司 **2022 年度**第一大客户北京智芯及其下属企业系公司关联方，北京智芯系全国排名领先的集成电路设计企业，在智能电力相关芯片市场具有领先地位，对公司相关产品具有较大的市场需求。报告期内，公司对关联方北京智芯及其下属企业销售收入合计分别为 66.82 万元、1,449.30 万元及 **4,668.80 万元**，占营业收入的比例分别为 0.56%、4.44%及 **15.69%**，呈上升趋势，且未来随着双方业务合作关系的不断深入，公司对北京智芯的收入及收入占比可能进一步提高。

未来，若北京智芯的经营发展战略、采购战略等发生较大变化，或公司因自身发展原因导致与北京智芯之间的合作空间减少，将直接对公司的营业收入及经营业绩产生不利影响；此外，若未来关联交易相关的内部控制制度执行运作不够规范，则该等关联交易可能存在损害公司或中小股东利益的风险。

2) 应收账款及应收票据余额增长风险

报告期内，公司的主要客户为下游经销商及部分直销模式客户等，随着公司经营规模的提升及市场竞争力的增加，公司直销模式客户贡献收入占比呈上升趋势。相较经销商客户，直销模式客户通常在账期与结算方式等方面存在较强的议价能力，公司可能需要接受更长的账期，或接受商业承兑汇票等流动性相对偏弱的结算方式，因此公司未来存在应收账款余额、应收票据余额随着客户结构变化而增长的风险。此外，如某些客户的经营状况突然产生不利变化，公司不能及时、足额回收应收账款，则公司经营业绩可能受到不利影响。

3) 产品类型较为单一的风险

报告期各期，公司成品芯片中 DC-DC 芯片占主营业务收入比例分别 69.78%、69.21%和 **79.55%**，公司成品芯片中 DC-DC 芯片是公司最主要的产品类型，未来可能因市场竞争加剧、其他细分领域企业跨界竞争、下游行业需求量下降等不利因素，导致公司的产品销量减少或售价下降，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

（4）生产、产品及存货相关风险

1）存货减值风险

公司的产品属于电子元器件，虽然在通常的贮存条件下发生毁损、变质的风险较低，但部分下游客户可能对公司产品的封装出厂日期提出一定限制，导致公司库龄较长的库存商品存在一定的变现风险；此外，公司产品出现升级迭代后，原有型号的变现风险亦相应增加。公司对库龄两年以上的库存商品全额计提存货跌价准备，未来如公司产品因市场需求变化、市场竞争加剧、客户品控要求提升等导致部分存货变现困难库龄增加，则公司经营业绩可能受到不利影响。

2）产品质量风险

公司产品已广泛应用于网络通信、安防监控、智能电力、消费电子、智慧照明、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域众多知名客户，虽然客户通常会执行严格的测试、验证等程序以确认产品质量达标，但仍存在实际生产中发生质量问题的风险。若公司产品在研发、生产环节发生无法预料的质量问题，影响下游客户产品的性能，则可能对公司的品牌和信誉产生不利影响，产生可能超过公司所售产品价值的赔付义务，甚至可能导致客户流失，进而影响公司的经营业绩。

3）环境保护风险

公司的子公司从事的集成电路封装测试业务生产环境相对复杂，生产过程中不可避免会产生废水、废气及固体废物等污染物和噪声，存在因管理疏忽或者不可抗力事件发生环境污染事故的可能性，可能会给公司周围环境造成污染及违反环保相关的法律法规，对公司经营造成不利影响。另外，随着大众环保意识的增强，政府对环境保护的关注度在增加，未来环保部门可能会进一步提高对集成电路封装测试生产企业的环保要求，使公司加大环保设施投入及运营投入，增加环保成本，可能对公司经营业绩造成不利影响。

（5）研发与技术相关风险

1）产品研发及技术创新风险

公司的电源管理芯片产品主要应用于网络通信、安防监控、智能电力、消费电子、智慧照明、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，随着下游行业技术不断更新升级，对公司产品亦不断提出新的技术需求。因此，公司需结合客户诉求、行业发展趋势、市

场应用特点等因素持续研发投入，保持产品性能始终满足行业应用需求。然而集成电路产品的研发设计需要经过产品定义、开发、验证、流片、测试等多个环节，存在一定研发周期，并存在研发失败的风险。若公司未来产品研发速度不及行业升级需求或研发方向与行业需求相偏离，则存在产品市场认可度下降、研发资源浪费并错失市场发展机会等风险，进而对公司的经营效率和效果产生不利影响。

2) 技术人才储备不足及高端人才流失的风险

半导体及集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，电源管理芯片行业尤其依赖经验丰富的技术人才。未来随着业务规模增长及产品种类拓展需要，公司需不断扩充专业技术团队，以实现研发实力的稳步提升。然而，随着集成电路行业规模的不断增长及近年来国内集成电路行业的热度提升，集成电路行业参与者不断涌现，企业对核心人才的争夺日趋激烈。如果公司未能建立对现有人才的有效激励体系，或缺乏对新人才的吸引力，则面临核心人才流失、人才储备不足的风险，将对公司新产品的持续研发和市场拓展能力造成不利影响，从而在一定程度上削弱公司的持续盈利能力。

3) 核心技术泄密风险

公司所处行业具有技术密集型的特点，产品的核心技术是公司产品市场竞争力的重要基础。未来若公司的核心技术因保密措施失效等原因失密，将可能削弱公司产品技术优势，给公司市场竞争力和生产经营带来负面影响。

(6) 其他经营相关风险

1) 募集资金投资项目实施风险

①募集资金投资项目无法实现预期收益的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产折旧及无形资产摊销金额将增加，加之集成电路设计企业建设项目普遍具有研发投入大的特点，项目实施期间的研发费用投入亦将快速提升。同时，募集资金投资项目的实施对公司人力资源管理、资源配置、市场拓展和法律及财务风险管理等各方面能力提出了较高要求。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了审慎的可行性研究论证，但公司所处行业市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、公司项目管理及项目实施过程中出现的其他不可抗力因素都可能对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响，公司存在募集资金投资项目无法实现预期收益、公司利润水平下降的风险。

②项目投产后新增折旧摊销降低当期经营业绩的风险

根据公司本次募集资金投资项目使用计划，项目建成后，公司资产规模将出现较大幅度增加，年折旧摊销费用也将相应增加。其中，募集资金投资项目中固定资产投资合计为 90,671.53 万元，以公司现行固定资产折旧政策，房屋及建筑物及机器设备分别按 20 年及 10 年以直线法计提折旧，预计残值率均为 5%；无形资产投资合计为 1,705.34 万元，其中土地使用权按 50 年以直线法摊销，软件按 3 年以直线法摊销，预计在项目投产后第一个完整会计年度将新增折旧与摊销 6,950.12 万元，占当年度全部募投项目增量预测收入的比例为 8.11%。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，若因募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化，则新增折旧摊销将对公司未来的盈利情况产生不利影响。

③项目建设风险

本次发行募集资金投资项目之一“封装测试中心建设项目”与公司发展战略相匹配，实施后能够进一步提升公司的竞争优势，为公司的下一步发展奠定良好的基础。虽然该项目已经进行了充分的可行性论证，但在管理和组织实施过程中，仍存在工程进度、工程质量、设备价格、投资成本等因素发生变化的风险，工程组织和管理能力、项目建设进度、预算控制、设备引进与技术合作情况、项目建成后其设计生产能力与技术工艺水平是否达到设计要求以及是否出现意外事件或不可抗力，都会对项目的顺利达产造成影响。

④募集资金摊薄即期回报风险

若本次首次公开发行能够顺利实施，公司净资产将大幅增长，但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润可能难以实现同步增长，公司每股收益在发行后的一定期间内将可能被摊薄，存在净资产增长较快导致即期回报被摊薄的风险。

2) 租赁房屋的风险

截至上市保荐书签署日，发行人共计租赁 23 处房屋用于办公、生产经营等。如果同时出现多处租赁协议被解除或无法续期的情况，将对发行人持续经营产生不利影响。

发行人部分租赁的房屋存在出租方未提供产权证书或其他权属证明文件或相关主管部门批准房屋建设的许可文件的问题，可能导致发行人无法继续使用该等房屋的风险。

针对其中 1 项用于生产的租赁房屋，发行人已经取得了成都市郫都区现代工业港管理委员会出具的《关于四川蕊源集成电路科技有限公司厂房租用的情况说明》，发行人可以将该厂房持续用于生产经营，但是仍存在因租赁房屋的产权问题，可能导致需要搬迁的风险。

此外，发行人承租的部分房屋未办理房屋租赁登记备案的情形不符合《商品房屋租赁管理办法》的规定，存在被行政处罚的风险。

3) 税收优惠政策风险

报告期内，发行人子公司四川蕊源享受西部大开发企业所得税优惠税率。如果子公司未能持续符合相关税收优惠政策条件或国家相关税收优惠政策发生变化，子公司将不能继续享受上述税收优惠，则会对经营业绩和利润水平产生一定影响。

(7) 其他管理相关风险

1) 公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司逐步建立健全法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。公司组织结构和管理体系日益复杂，此次发行募集资金后，公司的规模将进一步扩大。公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加等变化，都对公司运营管理体系和运作机制提出更高的要求。若公司面对战略规划、制度建设、组织机构、资金管理和内部控制等方面的挑战而无法及时改进，经营管理水平不能与业务规模的扩张相适应、与发行上市后资本市场的要求相匹配，则公司可能受到管理风险带来的负面影响，将为公司的正常生产经营带来一定风险。

2) 共同控制风险

本次发行前，袁小云、刘涛和杨楷合计直接持有公司 52.1396%股份，合计控制公司 56.8369%表决权，三人签署了《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人。《一致行动协议》约定的有效期为至发行人成功上市满 36 个月，有效期届满后经各方协商一致可以续签。如果《一致行动协议》到期后不再续签，或其他股东增持股份谋求控制权的情形，将可能导致公司实际控制人变化，影响公司现有控制权的稳定。

3) 对赌协议的风险

发行人历史上曾经存在与博源新航、刘曜、杨斌及北京智芯签署含有特殊权利条款

协议的情况，但截至本上市保荐书签署日，发行人不作为任何特殊权利条款当事人，无需承担任何责任，相关特殊权利条款约定及解除情况符合《创业板股票首次公开发行上市审核问答》的要求。

但是，实际控制人与博源新航、刘曜、杨斌及北京智芯之间尚存在关于特殊权利约定及效力恢复约定，如该等权利恢复，则发行人实际控制人存在被博源新航、刘曜、杨斌及北京智芯要求回购股份的风险。

2、与行业相关的风险

（1）行业周期风险

公司产品下游主要应用场景包括网络通信、安防监控、智能电力、消费电子、智慧照明、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，近年来在技术升级、需求增长等因素推动下行业景气度较高。但未来随着市场不断发展成熟，终端需求增长或将放缓，对公司所处芯片市场增长驱动力度降低。同时，随着半导体产业链上下游的供需关系不断变化，产业链各环节业务扩张节奏有所差异，导致产业各环节景气度存在一定周期性波动，对集成电路设计企业在采购、销售等环节的经营带来一定影响。未来若上游产能供应不足的情形加剧或出现下游需求规模锐减等不利情形，公司可能面临产品交付稳定性下降等问题，从而对公司的经营水平带来一定不利影响。

（2）市场竞争和客户流失的风险

目前，电源管理芯片市场正处于快速发展阶段，随着新的市场参与者不断涌入，市场竞争也逐步加剧。而知名国际品牌普遍具有更深厚的技术积累、更全面的产品布局 and 更广泛的客户资源，因此能够通过不断的研发创新带动行业前沿技术革新，并保持其相对领先的市场地位，国内电源管理芯片企业仍需在技术研发、产品布局、运营管理等方面不断加强投入，为下游客户提供优质可靠的产品，才能在激烈的市场竞争中占据优势地位。未来若公司所处细分市场的竞争进一步加剧，可能会导致公司新客户开拓不力或现有客户流失，对公司盈利能力及市场份额造成不利影响。

（3）国际/地区贸易摩擦风险

近年来国际贸易政策形势时有变化，而集成电路行业具有高度国际化分工的特点，在贸易摩擦的国际市场环境下我国集成电路行业可能面临加征关税、技术限制等制约，不利于产业链的国际化拓展与升级。报告期内公司晶圆供应商主要来自韩国和中国台湾

等国家/地区，若未来国际/地区贸易摩擦加剧，则可能对公司与晶圆代工厂合作造成一定不利影响，从而降低公司业务运转效率。

（4）汇率风险

报告期内，公司晶圆及光罩主要自境外（含中国港澳台地区）采购，并通常以美元定价及结算；如未来美元对人民币升值，则公司以人民币计量的采购价格将上升，对公司盈利水平产生一定的不利影响。

3、其他风险

（1）发行认购不足的风险

投资者投资意向取决于股票供需关系、同时期市场环境以及投资者心理预期等因素，本次发行可能出现网下投资者股票申购数量低于网下初始发行量的情形，导致发行中止。

二、发行人本次发行情况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 1,420 万股（最终发行数量授权公司董事会与主承销商按照深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量协商确定）	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 1,420 万股（最终发行数量授权公司董事会与主承销商按照深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量协商确定）	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	本次发行不涉及股东公开发售股份	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 5,677.8012 万股（本次发行不采用超额配售选择权）		
每股发行价格	【】 元		
发行市盈率	【】 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益确定）		
发行前每股净资产	【】 元（按照本公司【】年【】月【】日经审计的净资产除以本次发行前总股本	发行前每股收益	【】 元（按照本公司【】年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母

	计算)		公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【】元(按照本公司【】年【】月【】日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)	发行后每股收益	【】元(按照本公司【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)
发行市净率	【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)		
发行方式	本次发行采用网下向询价对象配售发行与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或者中国证监会要求或认可的其他方式(包括但不限于向战略投资者、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票)		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(法律、法规及深圳证券交易所等业务规则禁止购买者除外),或中国证监会规定或认可的其他对象		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	本次发行无公开发售股份		
发行费用的分摊原则	本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费等由公司承担		
募集资金总额	募集资金总额预计【】万元		
募集资金净额	扣除新股发行费用后,募集资金净额【】元		
募集资金投资项目	电源管理芯片升级及产业化项目		
	研发中心建设项目		
	封装测试中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元,其中: 1、承销保荐费【】万元(不含增值税); 2、审计、验资费【】万元(不含增值税); 3、律师费【】万元(不含增值税); 4、与本次发行相关的信息披露费【】万元(不含增值税); 5、发行手续费及其他费用【】万元(不含增值税)		
(二) 本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日		
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日		
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日		
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在深交所创业板挂牌上市		

三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人

胡晓：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾负责和参与的项目包括：江苏恒立液压股份有限公司非公开发行项目、同方国芯电子股份有限公司非公开发行项目、沈阳机床股份有限公司非公开发行项目、宁夏中银绒业股份有限公司配股及非公开发行项目、崇义章源钨业股份有限公司非公开发行项目、同方股份有限公司非公开发行项目、广东超华科技股份有限公司非公开发行项目、紫光股份有限公司非公开发行项目、厦门银润投资股份有限公司非公开发行项目、中文在线数字出版集团股份有限公司重大资产重组项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张俊超：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾负责和参与的项目包括：福建省永安林业（集团）股份有限公司发行股份购买资产项目、中钢天源股份有限公司发行股份购买资产项目、环旭电子股份有限公司发行股份购买资产项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：王伟，于 2017 年取得证券从业资格，曾经参与执行天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换债券项目、阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票项目、广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票项目、极米科技股份有限公司首次公开发行股票项目、阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票项目等。

项目组其他成员：赵言、莫鹏、蒲乐、姚诚、吴非平、袁宇轩、廖柯宇、景洪杰

四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明

中金公司作为发行人的上市保荐机构，截至本上市保荐书出具日：

1、本机构自身及本机构下属子公司持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：

中金佳成投资管理有限公司系中金公司全资二级子公司，持有中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）1.9403%出资份额且担任中金启元的执行事务合伙人

（中金佳成于 2021 年 12 月 20 日注销，但工商尚未完成变更，中金佳成仍为中金启元的执行事务合伙人）。中金启元作为有限合伙人持有发行人股东博源新航 20.0000% 出资份额；博源新航持有发行人 2.2400% 股份。中金公司最终通过中金启元间接持有发行人 0.4480% 股份。

博源新航系经中国证券投资基金业协会备案的私募基金，中金公司通过上述主体间接持有发行人股份的情形均系相关主体所做出的独立投资决策，并非主动对发行人进行投资。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本机构、本机构控股股东、实际控制人及重要关联方股份的情况。

3、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

4、中金公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至 2022 年 6 月 30 日，中央汇金直接持有中金公司约 40.11% 的股权，同时，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司各持有中金公司约 0.02% 的股权。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。根据发行人提供的资料及公开信息资料显示，中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况，中金公司控股股东、实际控制人及重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或融资的情况。

5、本机构与发行人之间不存在其他关联关系。

本机构依据相关法律法规和公司章程，独立公正地履行保荐职责。

五、保荐机构承诺事项

1、保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

保荐机构同意推荐成都蕊源半导体科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

2、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条的规定，中金公司作出如下承诺：

（1）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深交所有关证券发行上市的相关规定；

（2）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（4）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（5）保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（6）保证本上市保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（7）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会、深交所的规定和行业规范；

（8）自愿接受中国证监会、深交所依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

中金公司承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

中金公司承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所对推荐证券上市的规定，接受深交所的自律管理。

六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序

（一）发行人董事会对本次证券发行上市的批准

2021年9月28日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》《关于募集资金投资项目及可行性的议案》《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于利润分配政策的承诺的议案》《关于上市后三年分红回报规划的议案》《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于公司作出的对欺诈发行上市的股份回购承诺的议案》《关于公司承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购和依法赔偿损失的议案》《关于公司及相关责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》《关于本次发行被摊薄即期回报相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案，对本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性以及其他必须明确的事项作出了决议，并提请股东大会审议。

（二）发行人股东大会对本次证券发行上市的批准

2022年4月2日，发行人召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》《关于募集资金投资项目及可行性的议案》《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》《关

于<成都蕊源半导体科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于<成都蕊源半导体科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于利润分配政策的承诺的议案》《关于上市后三年分红回报规划的议案》《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于公司作出的对欺诈发行上市的股份回购承诺的议案》《关于公司承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购和依法赔偿损失的议案》《关于公司及相关责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》《关于本次发行被摊薄即期回报相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。上述议案经出席本次股东大会的股东以所持表决权的 100%通过。

综上所述，发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深交所规定的决策程序。

七、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明

（一）发行人符合《证券法》规定的发行条件

保荐机构依据《证券法》第十二条关于申请发行新股的条件，对发行人本次证券发行是否符合《证券法》规定的发行条件进行了尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

1、发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定；

2、发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定；

3、发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定；

4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定；

5、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项之规定：中国证监会发布的《首次公开发行股票注册

管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）对于首次公开发行股票并在创业板上市规定了相关具体发行条件，保荐机构对发行人符合该等发行条件的意见请见下文第（二）部分。

保荐机构认为，发行人符合《证券法》规定的关于首次公开发行新股的发行条件。

（二）发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件

1、发行人系由成都蕊源半导体科技有限公司（以下简称“蕊源有限”）以截至 2020 年 10 月 31 日经审计的净资产折股后整体变更设立的股份有限公司。2021 年 4 月 15 日，公司召开创立大会暨 2021 年第一次临时股东大会，审议同意蕊源有限全体股东作为发起人，以蕊源有限截至 2020 年 10 月 31 日经审计的账面净资产折股整体变更设立成都蕊源半导体科技股份有限公司，公司总股本为 3,619.131 万股，每股面值 1 元。2021 年 4 月 15 日，信永中和出具“XYZH/2021CDAA60054”《验资报告》，验证截至 2021 年 4 月 15 日，公司已收到各股东以净资产折合股本 3,619.131 万股。

2021 年 4 月 25 日，成都市市场监督管理局向公司核发了《营业执照》。

综上，发行人系依法设立的股份有限公司，发行人自其前身蕊源有限 2016 年 7 月 19 日成立以来持续经营，发行人持续经营时间从蕊源有限成立之日起计算已超过三年，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2023CDAA6B0450）、《内部控制鉴证报告》（XYZH/2023CDAA6B0451 号），及发行人对有关事项的说明，并经审慎核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留意见的内部控制鉴证报告，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

4、发行人最近两年主营业务为电源管理芯片的研发、封测与销售。项目组通过走

访发行人经营场所、查阅发行人营业执照及业务合同等进一步验证了发行人主营业务未发生重大变化；发行人最近两年实际控制人一直为袁小云、刘涛、杨楷，没有发生变更。近两年内发行人董事、高级管理人员变化情况如下：

（1）董事的变动情况

最近两年内，发行人董事的变化情况如下：

主体	时间	董事会构成	变动原因
蕊源有限	2020 年初	董事长：刘涛 董事：袁小云、杨楷、杨浩波、吕和糠	-
	2020 年 2 月 15 日	董事长：袁小云 董事：刘涛、杨楷、杨浩波、吕和糠	选举袁小云为董事长
蕊源半导体	2021 年 4 月 15 日	董事长：袁小云 董事：刘涛、杨楷、杨浩波、吕和糠	蕊源有限整体变更设立股份公司，选举袁小云、刘涛、杨楷、杨浩波、吕和糠为公司第一届董事会董事，并选举袁小云为董事长
	2021 年 5 月 10 日	董事长：袁小云 董事：刘涛、杨楷、杨浩波、吕和糠、原义栋、李秀伟	新股东北京智芯拟对蕊源半导体增资，增加 2 名董事会席位，选举原义栋、李秀伟为新董事，原义栋、李秀伟自北京智芯增资款足额转入公司指定账户之日（2021 年 6 月 18 日）起计算任期和开始履职，任期截止时间与第一届董事会相同
	2021 年 7 月 9 日	董事长：袁小云 非独立董事：刘涛、杨楷、杨浩波、原义栋、李秀伟 独立董事：苟琴、王勇、干胜道	为完善公司内部治理结构，设立独立董事制度，原董事吕和糠辞职，选举 3 名独立董事苟琴、王勇、干胜道

（2）高级管理人员的变动情况

最近两年内，发行人的高级管理人员的变化情况如下：

主体	时间	高级管理人员	变动原因
蕊源有限	2020 年初	总经理：杨楷	-
蕊源半导体	2021 年 4 月 15 日	总经理：杨楷 副总经理：王先胜、杨浩波 财务负责人兼董事会秘书：杨浩波	蕊源有限整体变更设立股份公司，第一届董事会第一次会议审议通过了聘请高级管理人员的相关议案

除上述变动外，公司董事、高级管理人员近两年未发生其他变动。

发行人控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能发生变更的重大权属纠纷。

综上，发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

5、经核查，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

6、发行人主营业务为电源管理芯片的研发、设计、封测与销售。根据发行人的《公司章程》《营业执照》等文件，发行人经营范围为：“半导体技术开发；电子元器件、集成电路设计；销售计算机软硬件及技术咨询、技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”经审慎核查，发行人生产经营活动符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款之规定。

7、根据有关政府部门出具的证明、董事、监事、高级管理人员基本情况调查表及承诺函，并经互联网检索，与发行人全体董事、监事及高级管理人员的访谈，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第二款、第三款之规定。

综上所述，保荐机构认为，发行人本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件。

（三）发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）规定的上市条件

1、发行人本次证券发行符合《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2、发行人本次公开发行前总股本为 4,257.8012 万股，根据本次发行方案，本次发行股票数量不超过 1,420 万股，发行后总股本不低于 3,000 万股，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、发行人本次公开发行前总股本为 4,257.8012 万股，根据本次发行方案，本次发行股票数量不超过 1,420 万股，公开发行股份比例不低于 25%，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、公司选择适用《创业板上市规则》第 2.1.2 条第（二）项规定的上市标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

按照可比同行业上市公司的估值水平，公司预计市值不低于人民币 10 亿元；同时根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2023CDAA6B0450 号），公司 **2022 年度**实现归属于公司股东的净利润 **6,812.48 万元**，实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 **6,721.05 万元**，**2022 年度**实现营业收入 **29,754.72 万元**，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项的规定。

综上，保荐机构认为发行人符合《创业板上市规则》规定的上市条件。

（四）发行人符合创业板定位

1、发行人技术创新性的核查情况

经查阅行业研究报告、公司产品明细、产品及竞品相关技术参数文件、报告期内财务数据、核心技术相关专利文件、核查公司核心技术团队简历并向核心技术人员了解技术应用情况，保荐机构认为发行人具备较强的创新能力，属于成长型创新创业企业，符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第二条规定。

2、发行人成长性的核查情况

(1) 经查阅行业研究报告及公司产品明细，保荐机构认为发行人对所处市场空间的表述准确。

(2) 报告期内发行人收入、利润变动情况符合成长性特征

报告期内，公司的资产和业务规模呈快速增长趋势。**2020 年度至 2022 年度**，公司资产总额和营业收入年均复合增长率分别达 **87.65%和 58.06%**，增速较高。因此，公司报告期内收入、利润规模高速增长，符合成长性特征。

(3) 发行人成长性来源于其核心技术及产品

经核查公司报告期内财务数据及收入明细资料、查阅核心技术相关专利文件、向核心技术人员了解技术应用情况，保荐机构认为发行人成长性来源于其核心技术及产品，具体如下：

公司核心技术在产品中应用情况如下：

序号	核心技术	主要应用产品
1	非对称低阻抗 MOS 管技术	多类型电源管理芯片
2	五管运放单元模块技术	多类型电源管理芯片
3	广输入高稳定电压控制技术	多类型电源管理芯片
4	电流模 Buck 直流转换器高速响应技术	DC-DC 芯片
5	DC-DC 芯片低电磁干扰技术	DC-DC 芯片
6	带温度补偿的全范围输入电压调节器技术	DC-DC 芯片
7	限流双保护技术	马达驱动芯片等
8	高兼容性 SOT 封装引线框架	芯片封装

公司核心技术主要用于公司不同型号的芯片产品中。报告期内，公司核心技术收入贡献情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
核心技术贡献收入	29,497.12	31,891.05	11,645.49
主营业务收入	29,711.72	32,558.89	11,910.66
占主营业务收入的比例	99.28%	97.95%	97.77%

报告期内，公司核心技术贡献收入占比均超过 97%，可见公司成长性来源于核心技术及产品。

（4）发行人创新能力能够支撑其成长

经查阅发行人产品及竞品相关技术参数文件、查阅产品相关专利文件、查阅行业研究报告、核查公司核心技术团队简历并访谈核心技术人员、访谈发行人客户、查阅公司收入成本明细，保荐机构认为发行人具有突出的技术创新优势，并基于技术方面优势逐步在客户及成本等方面形成积累，从而占据了一定市场地位，在公司持续投入研发的驱动下，公司创新能力能够支撑其成长。

（5）发行人成长性具有可持续性

经查阅行业研究报告、发行人产品及竞品相关技术参数文件、产品相关专利文件、公司收入成本明细、产品明细、客户明细、在手订单资料、晶圆入库明细、入库产品封测明细等方面资料，保荐机构认为公司所处芯片行业在政策支持、国产化大趋势、电子设备发展等趋势带动下具备持续发展的市场环境，同时在需求端公司基于在产品范围、技术开发、客户覆盖、市场地位等方面的积累具备持续获取客户和订单的能力，在供应端晶圆供应稳定且自建封测的持续交付能力的支持下，公司成长性具有可持续性

3、发行人符合创业板行业领域的核查情况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”，行业代码“I65”。

公司所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第五条和第六条规定。

4、发行人符合创业板定位相关指标的核查情况

公司最近三年（2020 年至 2022 年）研发投入复合增长率为 17.52%，最近一年（2022 年度）研发投入金额为 1,761.14 万元，最近三年（2020 年至 2022 年）营业收入复合增

长率为 **58.06%**，符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第三条“（一）最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年研发投入金额不低于 1,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%”的规定。

5、发行人顺应国家经济发展战略和产业政策导向的核查情况

经查阅相关产业政策文件及行业研究报告，保荐机构认为，发行人所属的芯片行业是国家长期重点支持的战略性行业，近年来已出台一系列鼓励政策，且由于芯片行业对宏观经济及高新技术的发展影响深远，未来国家仍将长期支持芯片行业的发展，同时受近年贸易摩擦和科技争端导致的断供风险影响，加速实现供应链国产化已成为行业安全发展的重点需求，公司对部分境外品牌型号形成替代，有效推进了供应链国产化发展，高度契合经济发展的迫切需求。因此，发行人顺应国家经济发展战略和产业政策导向。

综上，保荐机构认为发行人符合创业板定位。

八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

本机构在持续督导期间，将履行下列持续督导职责：

事项	安排
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露义务； 2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理办法》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； 2、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项； 3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人执行已制定的《对外担保制度》等制度，规范对外担保行为； 2、持续关注发行人为他人提供担保等事项； 3、如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐

事项	安排
	机构，并督导其履行相关信息披露义务。
6、保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员或保荐机构聘请的第三方机构列席发行人的股东大会、董事会和监事会会议，对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见； 2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员或聘请的第三方机构定期对发行人进行实地专项核查。
7、发行人和其他证券服务机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、发行人已在保荐协议中承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，及时、全面提供保荐机构开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和资料，并确保发行人董事、监事、高级管理人员尽力协助保荐机构进行持续督导； 2、发行人如聘请律师事务所和/或其他证券服务机构协助其在持续督导期间履行义务的，应督促该等证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。

首次公开发行股票并在创业板上市的,持续督导期间为股票上市当年剩余时间以及其后三个完整会计年度。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，本机构将继续完成。

九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

保荐代表人：胡晓、张俊超

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

邮编：100004

电话：（010）6505 1166

传真：（010）6505 1156

十、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，发行人成都蕊源半导体科技股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《创业板上市规则》等法律、法规的规定，发行人具备在深交所创业板上市的条件，同意推荐发行人在深交所创业板上市。

（以下无正文）

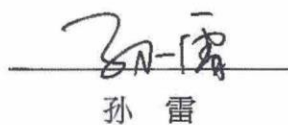
(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于成都蕊源半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书》签章页)

法定代表人:


沈如军

2023年6月19日

保荐业务负责人:


孙雷

2023年6月19日

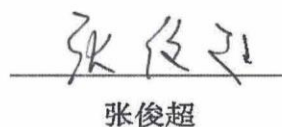
内核负责人:


章志皓

2023年6月19日

保荐代表人:


胡晓


张俊超

2023年6月19日

项目协办人:


王伟

2023年6月19日

保荐人公章

中国国际金融股份有限公司



2023年6月19日